产测环境搭建说明

1环境需要

1.1 硬件

产测一体板,

杜邦线,

电脑,

mini 口 USB 线,

阿莫烧录器(如果需要烧录出厂固件)。

1.2 软件

产测上位机软件,

串口调试助手 sscom 等。

1.3 github 资料介绍

产测工具相关的所有资料都可以从 github 上获取:

 $https://github.com/munanqiu/ING_RF_Tester/tree/main$

github 目录如下图所示:

01-bin for MCU	golden固件	上传downloader工具
02-sch-pcb	golden原理/pcb	第一次上传
03-upper software	上位机软件	更新版本号为1.5.2,增加了透传模式,上位机可以通过evl
■ 04-doc	使用说明	更新产测环境搭建说明

1.4 名词解释

golden: 产测一体板的别称

DUT:被测设备,即需要接受监测的芯片/模块

2 测试过程

从上位机发送测试开始,到 golden 反馈测试完成,中间大致分为:烧写测试固件、射频测试、出厂固件烧写三个过程。

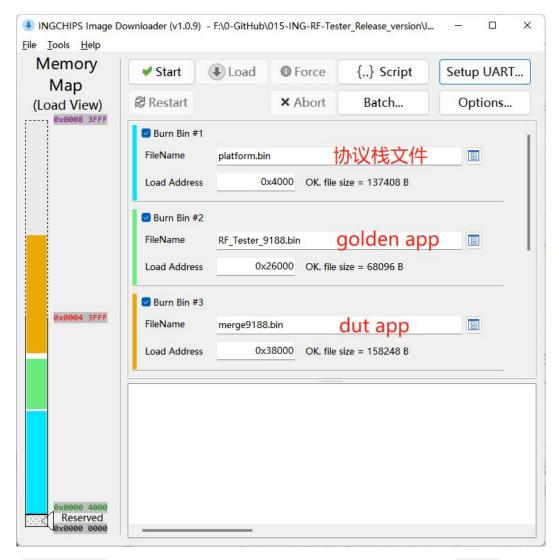
2.1 烧写测试固件

在环境部署阶段,golden 需要烧写三个 bin 文件(此过程可以由原厂工程师辅助完成,也可参照下面步骤操作)。

烧写的固件在 github 上的 01-bin for MCU 目录下, 目录下的三个文件下如下:



打开 downloader 下的 icsdw918.exe 工具,通过"file--open .ini file..."操作导入对应芯片(918 则选择 evk-918 文件夹,916 则选择 evk-916 文件夹)文件夹下的 flash_download.ini 文件,以 916 为例,导入后界面如图:



在 Setup UART 中选择对应的串口和波特率(推荐 460800)后,点击 start 按键,然后让 golden 进入 load 模式,就可以开始下载。

918 和 916 都需要下载 3 个固件,其中协议栈和 golden app 是 golden 运行的固件,dut app(merge9188.bin)是存储在 golden 的 Flash 里,测试时通过串口烧写到 DUT 里的固件。

因此,如果后续有固件更新,要分清更新的是哪个 bin,进行替换即可(当然也可一起全部更新)。

注意:

更新 golden 固件的时候需要断开 amo 和 dut,保证烧录的串口不被干扰,否则有可能握手失败

2.2 射频测试过程

射频测试过程分5个环节:

TX cnt

DUT 发射一定包数(比如 100 包),golden 接收,接收超过一定阈值认为测试通过。

TX power

DUT 以 0dbm 发射,golden 接收并检测信号强度,强度超过某个阈值(比如-35dbm)认为测试通过。

RX cnt

golden 发射一定包数(比如 100 包),DUT 接收,收到包数超过一定阈值认为测试通过。

RX power

golden 以 0dbm 发射,DUT 接收并检测信号强度,强度超过某个阈值(比如-40dbm)认为测试通过。

Freq offset

DUT 发射信号,golden 测试其频偏,如果发现频偏过大,golden 会通过软件进行调试,并把调试值写入 Flash 固定地址。

当前调试的频偏配置存储在如下 Flash 地址处,可以根据需要调整。

Plain Text

#define FLASH_FREQ_ADDR 0x0207F000

存在一定可能软件无法将频偏调到要求范围内,就需要通过调整 24M 晶振的电容来调节频偏。(918 不支持软件调节频偏,因此只能通过测试结果看到当前频偏值,如果频偏较大需要调整晶振的匹配电容)

注意: 烧写到 DUT 的 flash 中的频偏值为 2 个字节,第一个字节是本身的频偏值,第二个字节则是频偏值本身和 0xFF 异或的值,用来给用户提供频偏值是否被篡改的校验,可以自行决定是否使用该频偏值

2.3 出厂固件烧录

测试完成后,通过控制**阿莫烧录器**烧录出厂固件,此步骤是可选的:

- 如果选择不烧录出厂固件,则测试完成后会直接上传测试结果。
- 如果选择烧录出厂固件,则烧录完成后再上传测试结果。
- 对于 918, golden 不支持出厂烧录固件

2.4 透传模式

测试完成,并且烧录完成出厂固件之后,用户如果想根据自己烧录程序中已经定好的通讯协议读出 DUT 相关信息,

可以使用此模式来使用上位机直接和 DUT 通讯

- 注意,需要事先设置好上位机和 DUT 通讯的波特率、校验方式之后才能进行通讯
- 退出透传模式无需手动操作,golden 会在执行其他功能的时候自动执行退出

3 通讯协议

上位机与 golden 之间设计了一套串口通讯协议,用来配置测试流程和获取测试结果。 协议里上位机的每一条指令从机都需要进行对应的回复,上位机要有超时重发机制。

3.1 协议格式

一条完整的数据包由**帧头、类型、命令长度、命令、crc、帧尾**6个字段构成,如下图 所示:



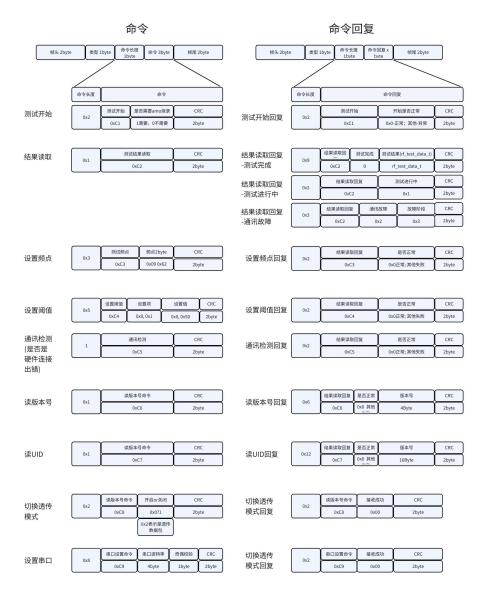
字段说明:

- 类型:产测一体板内部有多种协议,类型字段用于区分不同的协议。对于上位机与 golden 的通讯来说,上位机发送给产测一体板的类型固定为 0x4,产测一体板回复给上位机的类型固定为 0xF4。
- 命令长度:后面的命令和结果两个字段的长度。
- 命令: 具体的命令类型, 如测试开始、通讯检测等, 详见 3.2。
- crc: 计算从帧头到 crc 前所有字段的 crc 值. 计算参考代码如下:

```
C++
unsigned short check_crc16(char *puchMsg , unsigned short
usDataLen)
{
   unsigned char uchCRCHi = 0xFF ; /* high byte of CRC
```

3.2 不同的命令

目前实现的命令如下:



3.2.1 测试开始-C1

命令

表示上位机开启一轮完整测试,有一个参数:是否需要 amo,长度1个字节。

1: 带 amo 烧录,测试完成之后使用 amo 烧录出厂固件,需要连接阿莫烧录器。 (918 不支持 amo 烧录,在使用中禁用)

0: 不带 amo 烧录,测试完成之后整个流程直接结束。

回复

表示 golden 收到了上位机的开始测试命令,有一个参数:是否正常开始。

0: 正常地开启了测试。

其他: 开启测试失败。

3.2.2 结果读取-C2

命令

主动读取测试结果, 无参数。

回复

回复有三种情况, 会有不同的参数。

1) 测试完成, 会有两个参数: 测试完成(0x0)和测试结果。

测试结果使用下面的数据结构存储,前面 $5 \land byte$ 分别表示测试的各项结果,第 $6 \land byte$ 的 $5 \land bit$ 表示各项测试是否通过。

```
typedef struct {
    uint8_t tx_cnt;
    uint8_t rx_cnt;
    int8_t tx_power;
    int8_t rx_sen;
    int8_t freq_offset;
    struct {
        bool tx_cnt_pass : 1; // 1-bit flag for pass/fail
        bool rx_cnt_pass : 1;
        bool tx_power_pass : 1;
        bool rx_sen_pass : 1;
        bool freq_offset_pass : 1;
    } status;
} rf_test_data_t;
```

- 2) 测试进行中,有一个参数:测试进行中(0x1)。
- 3) 通讯失败, 有两个参数: 测试失败(0x2) 和失败阶段。

失败阶段通过下列数据结构定义,可以用来定位出问题的位置。

这里的失败通常是硬件线路问题,如串口线松了,供电问题等。如果是发生在 0-5,则 DUT 和 golden 的连接或者 DUT 的供电出了问题。如果发生在 6 阶段(阿莫烧写),则是与阿莫相关的连接、供电出了问题。

```
Bash
typedef enum {
   COMM ERR STAGE BURNING TEST
                                 = 0,
                                          //burn test image
                                  = 1,
   COMM_ERR_STAGE_TX_CNT_TEST
                                          //tx count test
                                  = 2,
   COMM_ERR_STAGE_TX_POWER_TEST
                                          //tx power test
   COMM_ERR_STAGE_RX_CNT_TEST
                                          //rx count test
                                   = 3,
   COMM_ERR_STAGE_RX_SEN_TEST
                                   = 4,
                                          //rx sensitivity
```

说明

golden 完成整个测试过程后会主动发送测试结果,主机也可以发送结果读取,但是如果测试还没有完成,就需要过一段时间再次读取。

3.2.3 设置频点-C3

命令

设置射频测试使用的频点。有一个参数,两个字节,表示频点,范围 2402-2480。 如果上位机进行了设置,就使用配置的频点测试,如果没有调用此命令进行设置,则 会使用随机生成的 2402-2480 内的一个频点进行测试。

回复

回复设置结果,有一个参数: 0-设置成功;其他-设置失败。

• 说明:

产线内有多个测试工位同时执行测试时,则要对使用的频点进行规划,如果两个临近工位同时使用相同频点测试,会互相干扰,导致两边的测试数据同时变差。

如果同一时间只有一个工位进行测试,则要避开环境中干扰比较大的频点。

如果有条件,将 golden 和 DUT 屏蔽在一个空间内可以获得最好的测试效果。

3.2.4 设置阈值-C4

命令

设置发送总包数(tx cnt 和 rx cnt 阶段使用)和测试的阈值。有两个参数: 设置项,长两个字节。有 0x1-0x5 五个类别,分别表示**总包数,tx_power 阈值**, tx_cnt 阈值,rx_sen 阈值,rx_cnt 阈值。

```
Plain Text
typedef enum : uint8_t
{
    PACKET_CNT = 1,
    TX_POWER = 2,
```

```
TX_CNT = 3,

RX_SEN = 4,

RX_CNT = 5

}threshold_switch;
```

设置值,实际配制的值,有两个字节。比如总包数设置 100, tx_power 设置-35。

回复

回复设置结果: 0-设置成功; 其他-设置失败。

- 说明
- 1) TX_CNT 和 R_CNT 的阈值表示收到的包数,收到一定包数以上测试合格,比如设置阈值 80,则 80 包以上合格。
- 2) TX_POWER 和 RX_SEN 都是 rssi,单位是 dbm,收到的信号强度强于阈值测试 合格。
- 3) PACKET_CNT 是测试使用的总包数,建议设成 100,设置过大会增加测试时间,且需要对应地调整阈值。

3.2.5 通讯检测-C5

命令

检测通讯是否正常, 无参数。

回复

回复通讯检测的结果,带1个参数:0-正常;其他-不正常

• 说明: 当前版本通讯检测只能检测上位机与 golden 通讯是否正常,无法检测 golden 和 DUT 是否连接正常,以及 golden 和 amo 是否连接正常,后续版本会进行优化。

3.2.5 读版本号-C6

命令

读取当前 golden 固件的版本号,不带参数。

回复

回复读取到的版本号,有两个参数:

是否正常: 0-正常; 其他-异常

版本号: golden 固件版本号的 ASCII 码, 版本号的格式为 V1.0.0。

3.2.6 读取 UID-C7

命令

读取当前测试的 DUT 的 UID, 不带参数

回复

回复读取到的当前 DUT 的 16byte 的 UID, 有两个参数:

是否正常: 0-正常; 其他-异常

UID: DUT 的 UID, 长度 16 字节, HEX 形式

3.2.7 透传模式-C8

命令

进入透传模式, evk 仅作数据中转, 上位机可与 dut 直接交互。

• 回复

回复设置结果: 0-设置成功; 其他-设置失败。

说明:此模式用于阿莫烧录出厂固件之后,需要出厂固件支持透传模式。

3.2.8 设置透传模式下 evk 与 dut 交互串口参数-C9

命令

更改 evk 和 dut 交互串口的参数,包括波特率以及校验方式

回复

回复设置结果: 0-设置成功; 其他-设置失败。

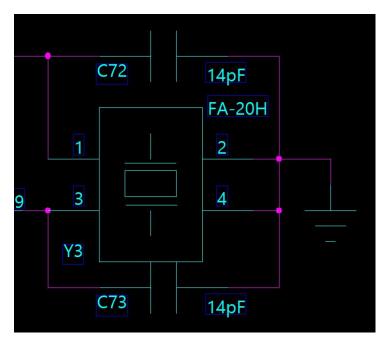
4 环境搭建

4.1 频偏测试

射频测试的最后一个过程——频偏测试过程,golden 通过接收 DUT 的信号来测 DUT 的频偏,需要 golden 本身频偏正常,因此每一块 golden 的频偏都需要单独测试并调整。

测试过程为通过烧录 SDK 自带的 BQB RF Test App, 在频谱仪上查看频偏, 并通过调整匹配电容(下图中的 C72, C73)来进行调整。

每一块 golden 的频偏都要调整到 0 附近。



此过程可由原厂协助完成,细节不再赘述。

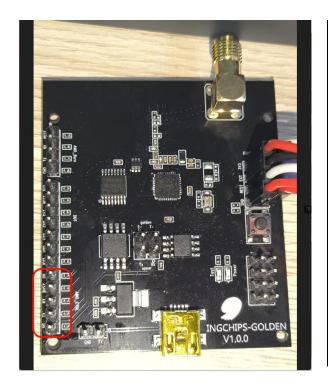
产测一体板的频偏每年都要进行一次测试与校准。

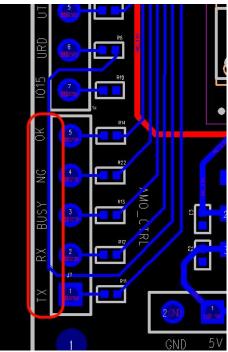
4.2 连线

如下图所示,必须连接的包括:

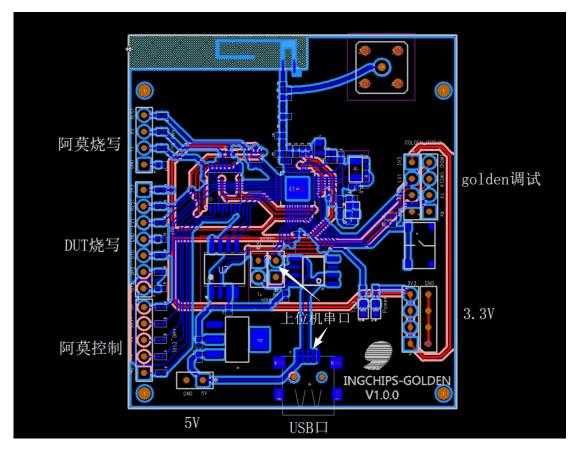
- 阿莫烧写: 连接阿莫烧录器的烧写引脚, 包 RST, RX, TX, GND, 共 4 根线, 无出厂固件烧录则不用连。
- DUT 烧写: 连接 DUT 的烧写引脚,包括 3V3,RST,EXT,GND,TX,RX, 共 6 跟线
- 阿莫控制:连接阿莫烧录器的控制引脚,包括OK,NG,BUSY,TX,RX,共5根线

注意:此次硬件丝印有误,下一版会改为正确(右侧为正确的 amo 控制引脚连接顺序)





• 上位机串口:连接上位机,则可以直接连接 USB 口(此时两个端子需要插上跳线),如果连接其他 MCU,则去掉跳线,直接接上面的 TX 与 RX 两根线。



其他非必要引脚包括:

• golden 调试:用于调试阶段进行烧录及 log 打印,或者更新 golden 的固件,正式

量产时不需要。

• 3.3V: 一组 3.3V 电源和地,调试用。

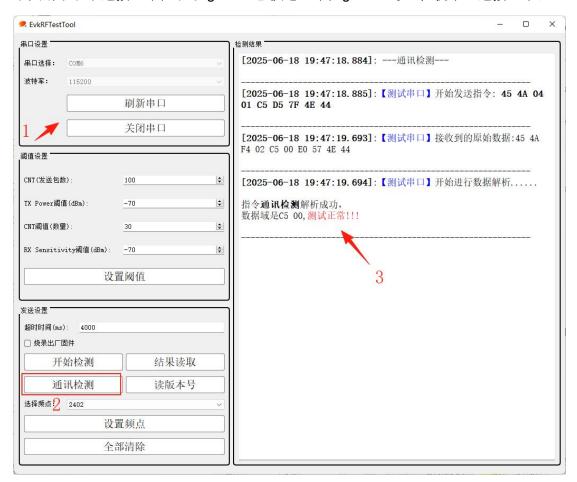
• 5V: 可以通过外部电源给线路板供电。

4.3 连接检测

将所有线路连接好并上电后,可以通过上位机检测系统是否工作正常。

此时通过 USB 接口连接上位机,首先刷新并连接串口,然后点击"**通讯检测**"按钮,可以在右侧窗口查看检测结果。

下图所示表示连接正常,表示 golden 已供电正常,golden 与上位机串口连接正常。



目前软件还未提供其他接口的连接检测,暂时需要人工检测,后续版本会增加。

4.4 阈值调试

实际搭建产测环境时,需要根据场地的实际情况来确定测试的各项阈值,包括:

- cnt 包数: 此次测试发送的包数基准, 范围是 1~255 包, 以 100 为例说明。
- TX cnt: DUT 发送 100 包,golden 接收,收到的包数高于某个阈值(比如

- 80), 认为合格。
- **TX power:** DUT 发送, golden 接收, 如果接收到的信号强度**强于**某个阈值(比如-30dbm),认为合格。
- **RX cnt**: golden 发送 100 包,DUT 接收,收到的包数**高于**某个阈值(比如 80),认为合格。
- **RX sen:** golden 以 0dbm 发送,DUT 接收,接收到的信号强度**超过**某个阈值 (比如-35dbm),认为合格。

四项参数中 TX cnt 和 TX power 为对射频发射部分的评估,RX cnt 和 RX sen 为对射频接收部分的评估。

测试环境不同,正常设备测试的数据会有不同,需要根据实际情况设定合适的阈值,以实现既不会把正常设备判定成损坏,也可以把损坏的设备检测出来。

5 协议数据举例

5.1 开始检测

Plain Text //上位机 45 4A 04 02 C1 00 20 66 4E 44 //golden 回复 45 4A F4 02 C1 00 20 55 4E 44

5.2 结果读取

Plain Text
//上位机
45 4A 04 01 C2 17 3E 4E 44
//golden 回复-测试完成以及测试结果
45 4A F4 08 C2 00 0A 1E E2 BA FD 17 DC 0C 4E 44
//golden 回复-测试进行中
45 4A F4 02 C2 01 10 94 4E 44
//golden 回复-通讯故障,发生在 tx cnt 测试阶段
45 4A F4 03 C2 02 02 62 91 4E 44

5.3 设置频点

Plain Text //上位机 45 4A 04 03 C3 62 09 70 E9 4E 44 //golden 回复 45 4A F4 02 C3 00 40 54 4E 44

5.4 设置阈值

按下设置阈值按钮后,会依次进行测试包数、tx power, tx cnt, rx sen, rx cnt 五个阈值的设置。

Plain Text //上位机设置测试包数 45 4A 04 05 C4 01 00 64 00 54 1F 4E 44 //golden 回复 45 4A F4 02 C4 00 70 56 4E 44 //上位机设置 tx power 的阈值 45 4A 04 05 C4 02 00 BA FF F0 06 4E 44 //golden 回复 45 4A F4 02 C4 00 70 56 4E 44 //上位机设置 tx cnt 的阈值 45 4A 04 05 C4 03 00 1E 00 8C 3D 4E 44 //golden 回复 45 4A F4 02 C4 00 70 56 4E 44 //上位机设置 rx sen (灵敏度)的阈值 45 4A 04 05 C4 04 00 BA FF 78 06 4E 44 //golden 回复 45 4A F4 02 C4 00 70 56 4E 44 //上位机设置 rx cnt 的阈值 45 4A 04 05 C4 05 00 50 00 A4 08 4E 44 //golden 回复 45 4A F4 02 C4 00 70 56 4E 44

5.5 通讯检测

Plain Text //上位机 45 4A 04 01 C5 D5 7F 4E 44 //golden 回复 45 4A F4 02 C5 00 E0 57 4E 44

5.6 读版本号

Plain Text //上位机 45 4A 04 01 C6 D4 3F 4E 44 //golden 回复 45 4A F4 06 C6 00 00 00 01 B1 95 4E 44

5.7 读取 UID

Plain Text //上位机 45 4A 04 01 C7 14 FE 4E 44 //golden 回复 45 4A F4 12 C7 16ByteUID CRC CRC 4E 44

5.8 设置透传模式

Plain Text //上位机 45 4A 04 02 C8 01 B0 A1 4E 44 //golden 回复 45 4A 04 02 C8 00 70 60 4E 44

5.9 设置 evk 和 dut 通讯串口参数

Plain Text //上位机 45 4A 04 06 C9 80 25 00 00 00 18 51 4E 44 //golde 回复 45 4A F4 02 C9 00 E0 52 4E 44

6 上位机软件

上位机界面如下图所示,分别包括: 串口设置、阈值设置、发送设置和检测结果4个

部分,其中发送设置部分分为正常检测和透传功能两个选项卡。



6.1 串口

刷新串口可以枚举当前电脑连接的虚拟串口,选择一体板对应的串口号连接。 波特率当前使用的 115200。

6.2 设置阈值

当前设置阈值分为五条指令分别设置,交互时间需要 10s 左右。

对于同一批产品在同样的环境中进行测试,每次上电后只要配置一次即可,配置会保存在产测一体板内。

但是如果产测一体板断电后重新上电,则需要重新配置。

6.3 发送设置

发送设置下有正常(正常测试)和透传两个选项卡。

6.3.1 正常测试



- 超时时间:上位机和 golden 通讯的超时时间,即 golden 如果在多长时间内没有回复,上位机认为本次通讯失败。
- 烧录出厂固件(复选框):如果连接了阿莫烧录器用于出厂固件烧录,则勾上此复选框,否则不要选。
- 空格键检测:将鼠标放在后面的输入框内,之后点击空格就会开启检测,和按下"开始检测"按钮效果相同,目的是方便产线操作。
- 结果读取:主动读取上一次的检测结果。
- · 通讯检测:检测上位机与 golden 是否通讯正常。
- · 读版本号:读取 golden 固件的版本号。
- 读取 UID:读取 dut 芯片的 UID。
- 设置频点:设置当前检测使用的频点,如果多个工位同时测试,使用同一个频点很可能形成干扰,要选择不同的频点。

6.3.2 透传

正常 透	传	
止市 22	. 1 4	
皮特率:	9600	~
校验位:	N	
OUT数据:	I	□ HEX发送
	发送配置	Ī.
注:发送D	UI数据之前先发送配置。	才生效!!!
	发送数据	Ē.
	人公双加	

透传模式时上位机和 dut 直接通讯,golden 充当透传的通道。

透传模式的存在,是为了上位机和 dut 的出厂固件进行交互,比如读取出厂固件的版本号等。因此想要使用透传模式,需要满足前提条件: DUT 烧写了出厂固件,且出厂固件支持透传相关协议。

- 发送配置:使用透传模式前需要先将与 DUT 连接的串口进行配置,配置项包括 波特率和校验选择两个。
- 发送数据:在 DUT 数据框内输入想要透传给 DUT 的数据,点击发送数据即可。 HEX 发送复选框可以选择数据的格式,为 ASCII 还是 HEX 格式。

7重要说明

7.1 频偏校准

硬件的频偏可能会随着时间推移发生偏移,因此 4.1 提到的频偏测试与校准,最好每年进行一次,否则可能导致产品的系统性频偏问题,如某些手机连接不上,容易断开等。

版本记录

文件版本	发布时间	说明
V1.0.0	2025/6/20	第一版发布
V1.1.0	2025/7/2	1)增加了第6部分重要说明 2)增加了 uid 读取协议 3)增加了 2.1 烧写测试固件的注意事项
v1.2.0	2025/7/5	增加了 UID 读取的流程
v1.3.1	2025/7/7	将频偏值烧录到 DUT 放到了 vendor 之后
v1.4.1	2025/6/9	取消烧录出厂固件之后再烧录频偏修改值,变为原始 在测试完成之后就烧录频偏修改建议值
v1.4.2	2025/7/17	增加了接入检测的超时流程,让接入检测更快
v1.5.2	2025/8/6	增加了 DUT 和上位机之间直接交互的透传模式
V1.6.1	2025/8/22	增加了 918 的适配,增加了上位机的说明